

## Beschreibung

Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und Polarisierung des piezoelektrischen Aktors

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und ein Verfahren zum Polarisieren des piezoelektrischen Aktors gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Piezoelektrische Aktoren bestehen üblicherweise aus gemeinsam gesinterten Stapeln von piezokeramischen Schichten mit dazwischenliegenden Metallelektroden. Jede zweite Metallelektrode ist an einer ersten Seite herausgeführt und mit einer ersten Metallisierungsbahn verbunden. An der gegenüberliegenden Seite ist eine zweite Metallisierungsbahn vorgesehen, die mit den anderen Metallelektroden elektrisch leitend verbunden ist. Somit sind zwei Metallelektrodenanordnungen vorgesehen, die voneinander elektrisch isoliert sind.

Beim Betrieb der piezoelektrischen Aktoren werden parallel zu einer Polarisationsrichtung der piezokeramischen Schichten große Kräfte, aber nur kleine relative Auslenkungen erreicht. Zur Erzielung geringer Betriebsspannungen besteht der piezoelektrische Aktor aus einer Vielzahl von piezokeramischen Schichten. Zur Polarisierung des Aktors wird an die zwei Elektrodenstrukturen ein elektrisches Polarisationsfeld angelegt, wodurch sich eine maximale remanente Polarisierung und eine geordnete Verteilung der in Feldrichtung in den Kristallen der keramischen Schichten ausgerichteten Domänen gegenüber einem unpolarisierten Ausgangszustand ergibt. Die Polarisierung wird bei einer Temperatur der piezokeramischen Schicht durchgeführt, die über der Curietemperatur der piezokeramischen Schicht liegt.

Weiterhin ist es zur elektrischen Kontaktierung des piezo-  
elektrischen Aktors erforderlich, die Metallisierungsbahnen  
mit elektrischen Leitungen zu kontaktieren. Dazu werden die  
elektrischen Leitungen in einem Lötprozess an den Metallisie-  
5 rungsbahnen festgelötet.

Aus der europäischen Patentanmeldung EP 0 350 941 A2 ist ein  
piezoelektrischer Aktor und ein Verfahren zur Herstellung des  
piezoelektrischen Aktors bekannt, der in Form von mehreren  
10 piezoelektrischen Schichten aufgebaut ist, wobei zwischen den  
piezoelektrischen Schichten jeweils eine Elektrode angeordnet  
ist. Jede zweite Elektrode ist mit einer Metallisierungsbahn  
elektrisch leitend verbunden, die an einer Außenseite des  
piezoelektrischen Aktors angeordnet ist. Die anderen Elektroden  
15 sind mit einer zweiten Metallisierungsbahn elektrisch  
leitend verbunden, die gegenüberliegend zur ersten Metalli-  
sierungsbahn auf der Außenseite des piezoelektrischen Aktors  
angeordnet ist. Der piezoelektrische Aktor wird für einen  
Verbindungsvorgang über die Curietemperatur erwärmt, so dass  
20 eine chemische Bindung zwischen den Elektroden und den piezo-  
keramischen Schichten ausgebildet wird. In einem folgenden  
Abkühlungsprozess wird die Polarisierung der piezokeramischen  
Schichten durchgeführt, wobei die Temperatur der piezokerami-  
schen Schichten noch über der Curietemperatur liegt. In einem  
25 späteren Lötprozess werden elektrische Leitungen an die Me-  
tallisierungsbahnen gelötet.

Aus der deutschen Patentanmeldung DE 100 26 635 A1 ist ein  
Verfahren zum Herstellen einer Lötverbindung zwischen einer  
30 elektrischen Kontaktfläche eines piezokeramischen Aktors und  
einer Drahtoberfläche beschrieben. Dabei werden Metallisie-  
rungstreifen des piezoelektrischen Aktors mit parallel ange-  
ordneten Drähten verlötet. Die Verlötung erfolgt nach der Po-  
larisierung des piezokeramischen Aktors. Bei dem Lötvorgang  
35 weist der piezokeramische Aktor eine Temperatur auf, die un-  
terhalb der Curietemperatur liegt.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktierung eines piezoelektrischen Aktors und ein Verfahren zur Polarisierung des piezoelektrischen Aktors bereit zu stellen, die schneller auszuführen ist.

Die Aufgabe der Erfindung wird durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 gelöst. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 weist den Vorteil auf, dass die elektrische Kontaktierung des piezoelektrischen Aktors und die Polarisierung des piezoelektrischen Aktors in kürzerer Zeit durchgeführt werden können. Dieser Vorteil wird dadurch erreicht, dass die elektrische Kontaktierung und die Polarisierung wenigstens teilweise gleichzeitig durchgeführt werden. Vorzugsweise wird der Lötvorgang oberhalb der Curietemperatur durchgeführt und gleichzeitig wird die Polarisierung der piezokeramischen Schichten des Aktors durchgeführt.

Weitere vorteilhafte Ausführungsformen der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.

In einer vorteilhaften Weiterbildung des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Polarisierungsspannung auch während einer Abkühlphase bis unter die Curietemperatur angelegt und auf einen maximalen Wert begrenzt. Damit wird zum Einen erreicht, dass die Polarisierung sicher beibehalten wird und zum Anderen wird eine Beschädigung der piezokeramischen Schichten vermieden.

In einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die Polarisierungsspannung schon vor Erreichen einer maximalen Temperatur angelegt und der fließende Strom wird während des Erwärmens des Aktors auf einen maximalen Wert begrenzt. Damit wird schon vor Erreichen der maximalen Temperatur des piezoelektrischen Aktors eine Polarisierung erreicht und gleichzeitig wird durch die Begrenzung auf einen maximalen Stromwert eine Beschädigung der piezokeramischen

Schichten sicher vermieden. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird die während der Polarisierung angelegte Spannung erfasst und ausgewertet, um eine Aussage über die Qualität der Polarisierung oder über die Qualität des piezoelektrischen Aktors machen zu können.

In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird der während der Polarisierung fließende Strom erfasst und ausgewertet, um die Polarisierung und/oder den piezoelektrischen Aktor bewerten zu können.

In einer bevorzugten Ausführungsform werden die Leitungen über Heizblöcke auf Lötflächen der Kontakte gedrückt, wobei die Heizblöcke den Aktor wenigstens teilweise erwärmen. Auf diese Weise wird der Lötprozess durch das mechanische Aufdrücken der Leitungen erleichtert und zudem wird die Temperatur im Bereich der Lötverbindung zugeführt. Damit wird eine Verbesserung des Lötprozesses erreicht.

In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform werden mehrere Aktoren gleichzeitig mit Leitungen verlötet und polariert. Damit wird eine effiziente Durchführung des Verfahrens erreicht, so dass eine Massenfertigung möglich ist.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 einen piezoelektrischen Aktor;  
Figur 2 einen Querschnitt durch einen Randbereich des piezoelektrischen Aktors nach dem Lötprozess;  
Figur 3 eine schematische Darstellung einer Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens; und  
Figur 4 ein Diagramm mit den zeitlichen Verläufen verschiedener Parameter während der Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

- Figur 1 zeigt in einer schematischen Darstellung einen piezokeramischen Aktor 1, der ein piezokeramisches Bauelement 2 mit einer Vielzahl von piezokeramischen Schichten 3 (Figur 2) aufweist. Zwischen zwei Schichten 3 ist jeweils eine flächige Elektrode 4 (Figur 2) ausgebildet. Die Elektroden 4 sind über Drähte 5 mit einem ersten bzw. einem zweiten Kontaktstift 6, 7 elektrisch leitend verbunden. Jede zweite Elektrode 4 ist über einen Draht 5 mit dem ersten Kontaktstift 6 elektrisch leitend verbunden. Die anderen Elektroden 4 sind über Drähte 5 mit dem zweiten Kontaktstift 7 elektrisch leitend verbunden. Auf diese Weise ist eine Schichtstruktur ausgebildet, wobei jede piezokeramische Schicht 3 von zwei Elektroden 4 begrenzt wird, die elektrisch leitend mit verschiedenen Kontaktstiften 6, 7 verbunden sind. Durch das Anlegen von verschiedenen Spannungspotentialen an den ersten und den zweiten Kontaktstift 6, 7 werden alle piezokeramischen Schichten 3 mit der gleichen Spannung beaufschlagt, so dass sich die Schichten 3 entsprechend der angelegten Spannung ausdehnen.
- Figur 2 zeigt einen Teilquerschnitt von einem Randbereich des piezokeramischen Bauteils 2. Auf dem piezokeramischen Bauteil 2 ist eine erste Metallisierungsbahn 8 aufgebracht. Die erste Metallisierungsbahn 8 ist elektrisch leitend mit jeder zweiten Elektrode 4 verbunden. Gegenüberliegend zur ersten Metallisierungsbahn 8 ist auf der anderen Seite des Bauteils 2 eine zweite Metallisierungsbahn 9 angeordnet, die mit den anderen Elektroden 4 elektrisch leitend verbunden ist. Die Metallisierungsbahn 8 ist über eine Lotschicht 13 mit den Drähten 5 elektrisch leitend verbunden. Die Drähte 5 der ersten Metallisierungsbahn 8 sind an den ersten Kontaktstift 6 geführt.

- In entsprechender Weise ist die zweite Metallisierungsbahn 9 über Drähte 5 elektrisch leitend mit dem zweiten Kontaktstift 7 verbunden.

Figur 3 zeigt eine schematische Anordnung zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens.

Bei der Herstellung des piezoelektrischen Aktors 1 werden zuerst die Schichten 3 und die Elektroden 4 in einem Sinterprozess hergestellt. Zudem ist es erforderlich, eine Polarisierung der piezokeramischen Schichten 3 durchzuführen. Dazu wird eine Polarisierungsspannung über die Elektroden 4 an die Schichten 3 angelegt; wobei die piezokeramischen Schichten 3 eine Temperatur aufweisen, die über der Curietemperatur der piezokeramischen Schichten 3 liegt. Weiterhin ist es erforderlich, elektrische Leitungen 10, 11 an die Metallisierungsbahnen 8, 9 anzuschließen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden in der dargestellten Ausführungsform drei piezoelektrische Bauteile 2 angeordnet. Die Bauteile 2 weisen bereits die piezokeramischen Schichten 3, die Elektroden 4 und die Metallisierungsbahnen 8, 9 auf. Die Metallisierungsbahnen 8, 9 sind an gegenüberliegenden Seiten und an diametral angeordneten Eckbereichen des im Querschnitt quadratförmig ausgebildeten Bauteils 2 angeordnet. An die erste und die zweite Metallisierungsbahn 8, 9 werden erste und zweite Leitungen 10, 11 angelegt. Die ersten und die zweiten Leitungen 10, 11 sind in Form von Drähten ausgebildet und mit einer Spannungsquelle 12 elektrisch leitend verbunden. Die Enden der Leitungen 10, 11 liegen an Abstandsblöcken 14 an.

Die Bauteile 2 werden auf eine Temperatur erhitzt, die oberhalb der Curietemperatur der piezoelektrischen Schichten 3 liegt. Anschließend werden die Leitungen 10, 11 gegen die erste und zweite Metallisierungsbahn 8, 9 gedrückt. Zudem wird Lot 13 zwischen die erste und die zweite Metallisierungsbahn und der ersten bzw. zweiten Leitung 10, 11 eingebracht. Als Lotmaterial wird Lot 13 verwendet, das eine Löttemperatur aufweist, die oberhalb der Curietemperatur liegt. Vorzugsweise werden zum Andrücken der ersten und der zweiten

Leitung 10, 11 Heizelemente 15 verwendet, die neben dem Andrücken der ersten und der zweiten Leitungen 10, 11 zugleich auch das Bauteil 2 wenigstens teilweise erhitzen. In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Lot 13 in Form einer Lot-  
5 folie 16 zwischen den Metallisierungsbahnen 8, 9 und den ersten und den zweiten Leitungen 10, 11 eingelegt.

Gleichzeitig zum Lötvorgang wird eine Polarisierungsspannung über die Spannungsquelle 12 an die Leitungen 10, 11 angelegt  
10 und dadurch die Polarisierung der piezoelektrischen Schichten 3 bewirkt. Bei der Polarisierung werden Feldstärken von 1 bis 2 kV/mm verwendet. Die verwendeten Stromwerte liegen bei einigen A/cm<sup>2</sup>. Vorzugsweise wird die Polarisierung schon vor Erreichen einer Maximaltemperatur des Bauteils 2 angelegt.  
15 Zudem wird vorzugsweise die Polarisierungsspannung beibehalten, wenn sich das Bauteil 2 von der maximalen Temperatur bis unter die Curietemperatur abkühlt. Damit die Stromstärke beim Erhitzen des Bauteils 2 nicht über einen Maximalstrom steigt, wird die Stromstärke von der Spannungsquelle 12 auf einen Ma-  
20 ximalwert begrenzt. Gleichzeitig wird die anliegende Spannung beim Abkühlen des Bauteils 2 von der Spannungsquelle 12 auf einen Maximalwert begrenzt, damit keine Beschädigung der piezokeramischen Schichten 3 erfolgt.

25 Die Leitungen 10, 11 sind oder werden an die ersten bzw. zweiten Kontaktstifte 6, 7 angelötet. Nach dem Löt- und Polarisierungsvorgang werden die Leitungen 10, 11 aufgetrennt, so dass einzelne Aktoren 1 gemäß Figur 1 erhalten werden.

30 Figur 4 zeigt in einem Diagramm den zeitlichen Verlauf der Polarisierungsspannung U und des Polarisierungsstromes I. Zudem sind in dem Diagramm ist die Temperatur T<sub>0</sub> an der Oberfläche der Metallisierungsbahn 8, 9 und die Temperatur T<sub>K</sub> der piezokeramischen Schichten 3 angegeben. In das Diagramm ist  
35 die Curietemperatur für die piezoelektrischen Schichten 3 und die Löttemperatur für das verwendete Lötmaterial eingetragen.

PCT/EP2004/051775

In dem Diagramm sind die Kennlinien über die Zeit  $t$  aufgetragen.

- Beim Beginn des Polarisierungs- und Lötvorganges sind die
- 5 Leitungen 10, 11 an die Metallisierungsbahnen 8, 9 ange-  
drückt, das Bauteil 2 ist noch nicht aufgeheizt und die Span-  
nungsquelle 12 hat noch keine Polarisierungsspannung ange-  
legt.
- 10 Zu einem ersten Zeitpunkt  $t_1$  wird die Polarisierungsspannung  
 $U$  angelegt. Gleichzeitig werden über die Heizblöcke 15 die  
Bauteile 2 aufgeheizt. Zu einem zweiten Zeitpunkt  $t_2$  erreicht  
die Temperatur  $TK$  der piezokeramischen Schicht 3 die Curie-  
temperatur. Mit ansteigender Temperatur steigt die Leitfähig-  
15 keit der piezokeramischen Schichten 3, so dass der Strom  $I$   
ansteigt und die Spannung  $U$  sinkt. Zu einem dritten Zeitpunkt  
 $t_3$  erreicht die Oberflächentemperatur  $TO$  der Bauteile 2 die  
Löttemperatur, so dass der Lötvorgang beginnt. Die Löttempe-  
ratur ist höher als die Curietemperatur. Zu einem vierten  
20 Zeitpunkt  $t_4$  ist der Lötprozess beendet und die Heizblöcke 15  
werden abgeschaltet, so dass das Bauteil 2 abkühlt. In dem  
Zeitraum zwischen dem dritten Zeitpunkt  $t_3$  und dem vierten  
Zeitpunkt  $t_4$  wird der maximal fließende Strom begrenzt. Nach  
dem vierten Zeitpunkt  $t_4$  sinkt sowohl die Oberflächentempera-  
25 tur  $TO$  als auch die Temperatur  $TK$  der piezokeramischen  
Schicht 3 ab. Durch die Abnahme der Temperatur steigt der Wi-  
derstand der piezokeramischen Schichten 3, so dass die Span-  
nung  $U$  wieder ansteigt. Die Spannungsquelle 12 sorgt dafür,  
dass die Polarisationsspannung  $U$  einen Maximalwert nicht ü-  
30 berschreitet. Dazu ist eine entsprechende Spannungsregelung  
in der Spannungsquelle 12 vorgesehen.

- Unterhalb der Curietemperatur entsteht zu einem fünften Zeit-  
punkt  $t_5$  ein Ladungsimpuls, der sich in einem kurzzeitigen
- 35 Ansteigen der Stromstärke  $I$  widerspiegelt. Der Ladungsimpuls  
kann zur Bewertung des piezoelektrischen Aktors 1 verwendet  
werden. Vorzugsweise wird der Ladungsimpuls mit einem Ver



- gleichladungsimpuls verglichen. Überschreitet oder unterschreitet der gemessene Ladungsimpuls den Vergleichsladungsimpuls um einen festgelegten Wert, so wird ein Defekt des piezoelektrischen Aktors erkannt. In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind Vergleichskurven für die Polarisationsspannung während des Polarisations- und Lötvorganges in einem Steuergerät 17 abgelegt. Das Steuergerät 17 vergleicht die während des Löt- und Polarisationsvorganges anliegende Spannungskurve und/oder die anliegende Stromkurve mit der abgelegten Spannungskurve bzw. der abgelegten Stromkurve. Aus dem Vergleich kann eine Aussage über die Qualität der Polarisierung und/oder über die Qualität des piezoelektrischen Aktors 1 getroffen werden. Weichen die gemessene Spannungskurve oder die gemessene Stromkurve um mehr als einen festgelegten Wert von der abgelegten Spannung- bzw. Stromkurve ab, so wird ein defekter Aktor 1 erkannt. Wird der Aktor 1 als defekt erkannt, so wird der Aktor 1 aussortiert und nicht weiter verarbeitet.

## Patentansprüche

1. Verfahren zum Herstellen einer elektrischen Kontaktie-  
rung eines piezoelektrischen Aktors (1) und zum Polari-  
sieren des piezoelektrischen Aktors (1), wobei der Ak-  
tor (1) wenigstens eine piezokeramische Schicht (3) aufweist, die zwei beabstandete elektrische Kontakte (4, 8, 9) aufweist, wobei an die elektrischen Kontakte (4, 8, 9) elektrische Leitungen (5, 10, 11) angelötet werden, wobei während des Lötvorgangs der piezoelektrische Aktor (1) auf eine Löttemperatur erwärmt wird, dadurch gekennzeichnet, dass während des Lötvorganges an die Leitungen (5, 10, 11) eine Polarisierungsspannung angelegt wird und die piezokeramische Schicht (3) polarisiert wird.
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass ein Lotmaterial (13) verwendet wird, dessen Löttemperatur über der Curietemperatur der piezokeramischen Schicht (3) liegt.
3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Polarisierungsspannung auch während eines Abkühlprozesses angelegt wird, und dass die Spannung während der Abkühlung des Aktors auf einen maximalen Wert begrenzt wird.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Polarisierungsspannung während eines Aufheizvorgangs vor Erreichen einer maximalen Temperatur angelegt wird, und dass der Strom während des Erwärmens des Aktors (1) auf einen maximalen Wert begrenzt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Spannung während der Polarisierung erfasst und ausgewertet wird, um die Polarisierung und/oder den Aktor (1) zu bewerten.
- 5
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der während der Polarisierung fließende Strom erfasst und ausgewertet wird, um die Polarisierung und/oder den Aktor zu bewerten.
- 10
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen (10, 11) über Heizblöcke (15) auf Lötflächen der Kontakte (8, 9) gedrückt werden, und dass die Heizblöcke (15) den Aktor (1) wenigstens teilweise erwärmen.
- 15
8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Aktoren (1) gleichzeitig mit Leitungen (10, 11) verlötet und polarisiert werden.
- 20
9. Verfahren nach Anspruch 8, dass die Leitungen (10, 11) eines Kontaktes (8, 9) einstückig für mehrere Aktoren (1) beim Verlöten und Polarisieren verwendet werden, und dass nach dem Verlöten und dem Polarisieren die Leitungen (10, 11) für jeden Aktor (1) in einzelne Leitungstücke aufgetrennt wird.
- 25
10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leitungen (10, 11) vor dem Verlöten und Polarisieren an Kontaktstifte (6, 7) angeschlossen sind.
- 30
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor (1) während des Lötvorganges über die Curietemperatur der piezokeramischen Schicht (3) erwärmt wird.
- 35

FIG 1

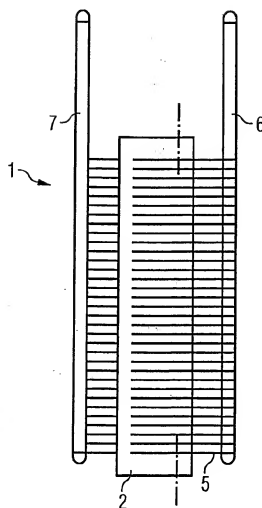
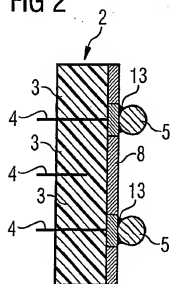
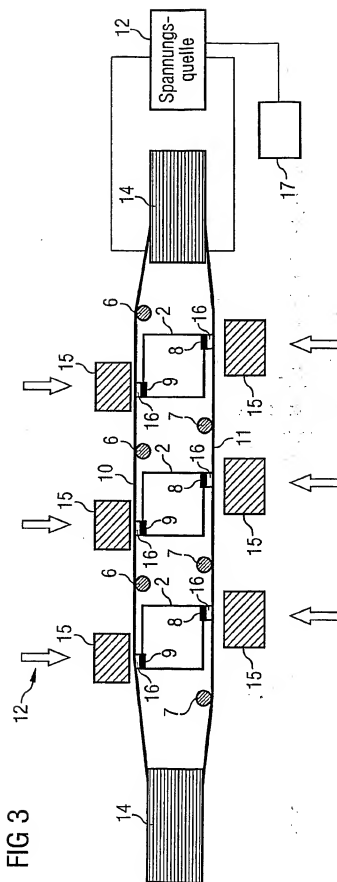
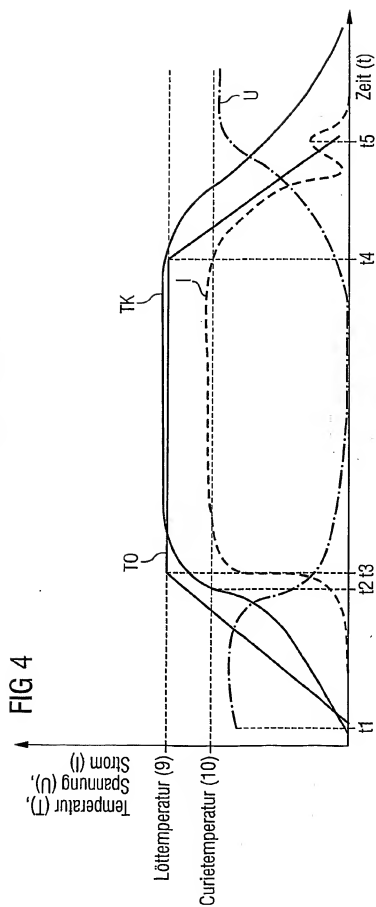


FIG 2







# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
P/EP2004/051775

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER  
IPC 7 H01L1/22 H01L1/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)  
IPC 7 H01L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0 350 941 A (HITACHI LTD) 17 January 1990 (1990-01-17) cited in the application column 2, line 46 - column 5, line 50 figure 1	1
A	DE 100 26 635 A (EPCOS AG ; SIEMENS AG (DE)) 3 January 2002 (2002-01-03) cited in the application paragraph '0001! - paragraph '0010!	1
A	DE 102 31 929 A (MURATA MANUFACTURING CO) 13 March 2003 (2003-03-13) paragraph '0021! - paragraph '0026!	1
A	US 5 325 012 A (SATO ICHIYA ET AL) 28 June 1994 (1994-06-28) abstract	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority date(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (see specification)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- \*A\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

9 November 2004

Date of mailing of the International search report

17/11/2004

Name and mailing address of the ISA  
European Patent Office, P.O. Box 5518 Patentkanal 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fac. (+31-70) 340-3015

Authorized officer

Steiner, M

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No.  
PCT/EP2004/051775

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
EP 0350941	A	17-01-1990	JP	2026087 A	29-01-1990
			JP	2738706 B2	08-04-1998
			DE	68919556 D1	12-01-1995
			DE	68919556 T2	13-04-1995
			EP	0350941 A2	17-01-1990
			US	5196756 A	23-03-1993
DE 10026635	A	03-01-2002	DE	10026635 A1	03-01-2002
DE 10231929	A	13-03-2003	JP	2003037306 A	07-02-2003
			DE	10231929 A1	13-03-2003
			US	2003020371 A1	30-01-2003
US 5325012	A	28-06-1994	JP	3039971 B2	08-05-2000
			JP	3218687 A	26-09-1991



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
EP2004/051775

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H01L41/22 H01L41/24		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7 H01L		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der Internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data, PAJ		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	EP 0 350 941 A (HITACHI LTD) 17. Januar 1990 (1990-01-17) In der Anmeldung erwähnt Spalte 2, Zeile 46 - Spalte 5, Zeile 50 Abbildung 1	1
A	DE 100 26 635 A (EPSCOS AG ; SIEMENS AG (DE)) 3. Januar 2002 (2002-01-03) In der Anmeldung erwähnt Absatz '0001! - Absatz '0010!	1
A	DE 102 31 929 A (MURATA MANUFACTURING CO) 13. März 2003 (2003-03-13) Absatz '0021! - Absatz '0026!	1
A	US 5 325 012 A (SATO ICHIYA ET AL) 28. Juni 1994 (1994-06-28) Zusammenfassung	1
<input type="checkbox"/> Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen <input checked="" type="checkbox"/> Siehe Anhang Patentfamilie		
<p>* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</p> <p>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</p> <p>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgelöst)</p> <p>"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</p> <p>"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</p> <p>"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Vorwissen des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie eingegeben ist</p> <p>"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahelegend ist</p> <p>"A*" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist</p>		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 9. November 2004		Abendedatum des internationalen Recherchenberichts 17/11/2004
Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5618 Patentlaan 2 NL - 2250 MV Rijswijk Tel: (+31-70) 340-2040, Tx: 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Steiner, M

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

●/EP2004/051775

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0350941 A	17-01-1990	JP 2026087 A	29-01-1990
		JP 2738706 B2	08-04-1998
		DE 68919556 D1	12-01-1995
		DE 68919556 T2	13-04-1995
		EP 0350941 A2	17-01-1990
		US 5196756 A	23-03-1993
DE 10026635 A	03-01-2002	DE 10026635 A1	03-01-2002
DE 10231929 A	13-03-2003	JP 2003037306 A	07-02-2003
		DE 10231929 A1	13-03-2003
		US 2003020371 A1	30-01-2003
US 5325012 A	28-06-1994	JP 3039971 B2	08-05-2000
		JP 3218687 A	26-09-1991